



MIP REPORT

Date: 21.05.2015

STEP-Analog/Digital/LVPS-Board-OHB-RP-01

1. INSPECTED UNIT

Part number	--
Part name:	STEP-Analog/Digital/LVPS-Board
Serial number	QM

2. INSPECTION TYPE

Type of inspection (solder, coating, final ...)	final
	Pass/ Fail/ Comments
Connectors/Saver	pass
Hardware assembly	Pass
Gluing	Pass (see comments)
Soldering	Pass (see findings on next page)
Cleanliness	pass

3. RESULTS

Part acceptable?	PCBs acceptable

4. COMMENTS

Build due to Manufacturing Flow Charts:

- STEP-LVPS-Board-OHB-XI-01 Iss: 1
- STEP-Digital-Board-OHB-XI-01 Iss: 1
- STEP-Analog-Board-OHB-XI-01 Iss: 1

Issues found during inspection at OHB are reported to CAU prior the MIP telecom (see findings on next page). CAU confirmed that the boards shall be used as is (see annexed Email).

Work to be performed prior coating on LVPS Board:

- rework of glue spots on C309 outer side and between C203/C204
- replacement of C315 (see list of open work)

5 SIGNATURE

Inspection performed: S. Vital
Name

21.05.2015
Date

Signature



Im Rahmen der Nacharbeiten der Testspitzen-Abdrücke haben wir ein paar Auffälligkeiten an Lötarbeiten entdeckt, die von CAU ausgeführt wurden.

LVPS:

Isolierung in der Lötstelle der Thermistorkabel.

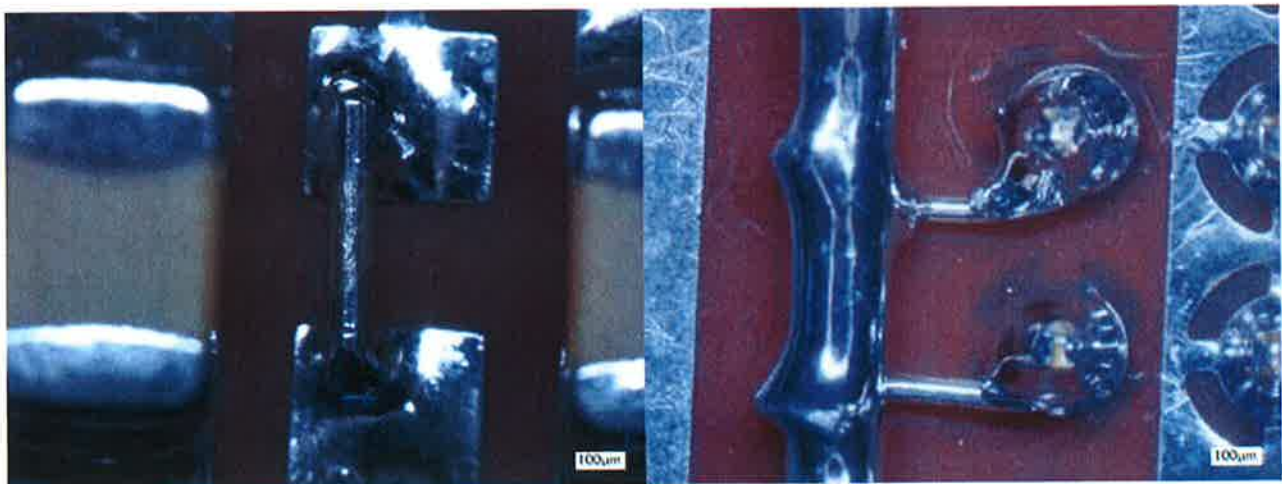
X301 (Aufsatzplatine) Die Verbindungsdrähte sind mit Silberdraht ausgeführt, der nicht verzinnt wurde – daher teilweise schlechte Benetzung. Es ist keine Zugentlastung in den Verbindungsdrähten ausgeführt.



Analog:

Es wurden Brückendrähte ohne Zugentlastung eingesetzt und sind mit Silberdraht ausgeführt, der nicht verzinnt wurde.

Die Verbindungsdrähte zum „Verteiler“ sind ohne Zugentlastung und mit Silberdraht – wie auch der Verteiler selbst – ausgeführt, der nicht verzinnt wurde.



Digital:

Isolierung in der Lötstelle der Thermistorkabel.



Es wurde von uns keine Nacharbeit dieser Auffälligkeiten gemacht!

Hannes Alexander

Von: Wimmer-Schweingruber <wimmer@physik.uni-kiel.de>
Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2015 13:57
An: Hannes Alexander
Cc: solo_kiel@physik.uni-kiel.de
Betreff: Solar Orbiter STEP PQM population MIP

Dear Mr. Hannes,

we give you the go-ahead to coat the STEP boards. We note that:
- there are some missing strain reliefs which have been omitted by CAU
- two capacitors could not be glued to the PCB

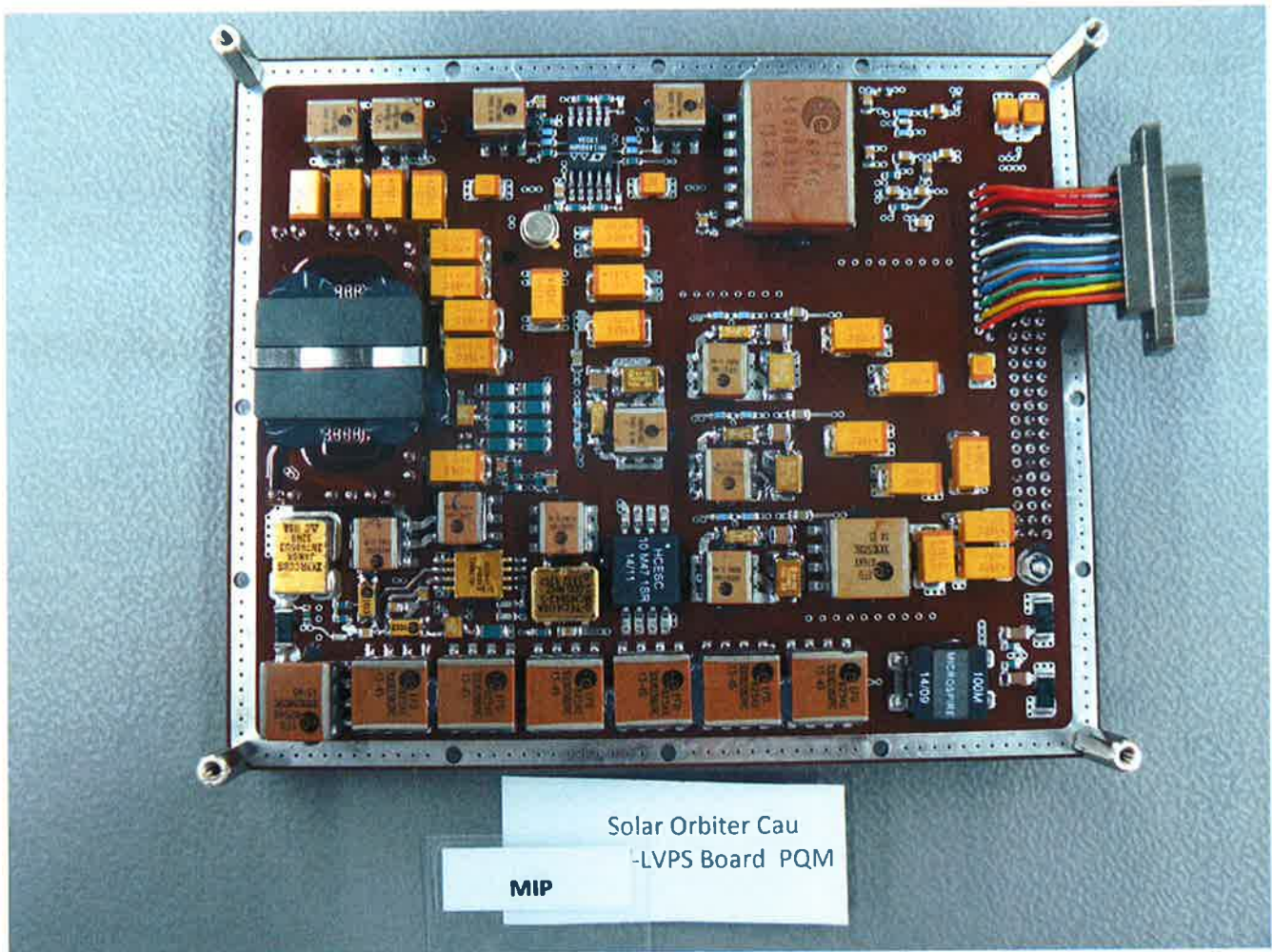
Before you coat the LVPS board, please replace the commercial capacitor with the appropriate flight part (Mahesh has these parts with him).

yours,

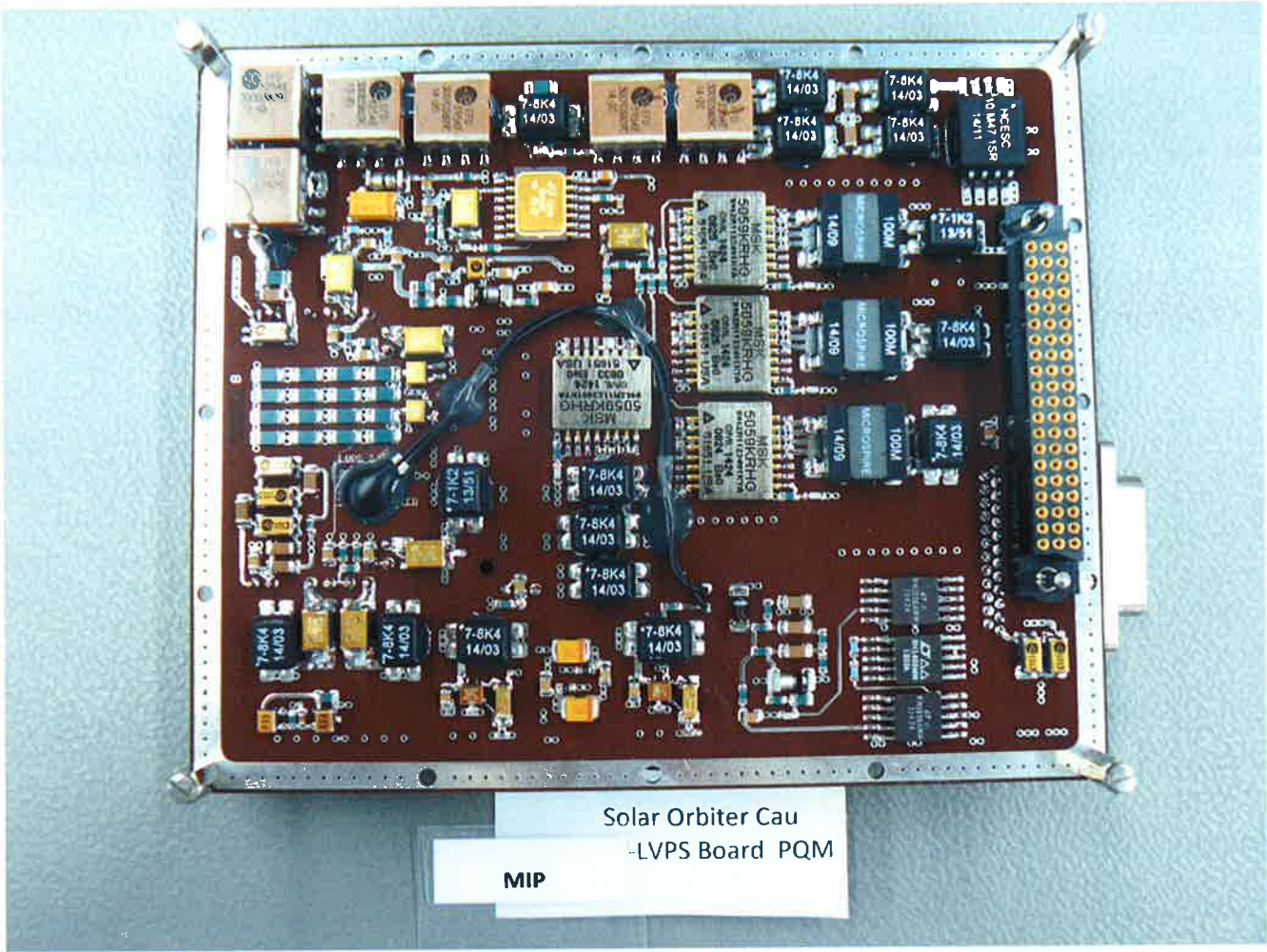
Bob Wimmer

Prof. Dr. Robert F. Wimmer-Schweingruber,
Institut fuer Experimentelle und Angewandte Physik,
University of Kiel,
Leibnizstrasse 11,
D-24118 Kiel
Germany
phone: (+) 49 431 880 3964; Fax: (+) 49 431 880 3968
e-mail: wimmer@physik.uni-kiel.de
www: [www: www.ieap.uni-kiel.de/et](http://www.ieap.uni-kiel.de/et)

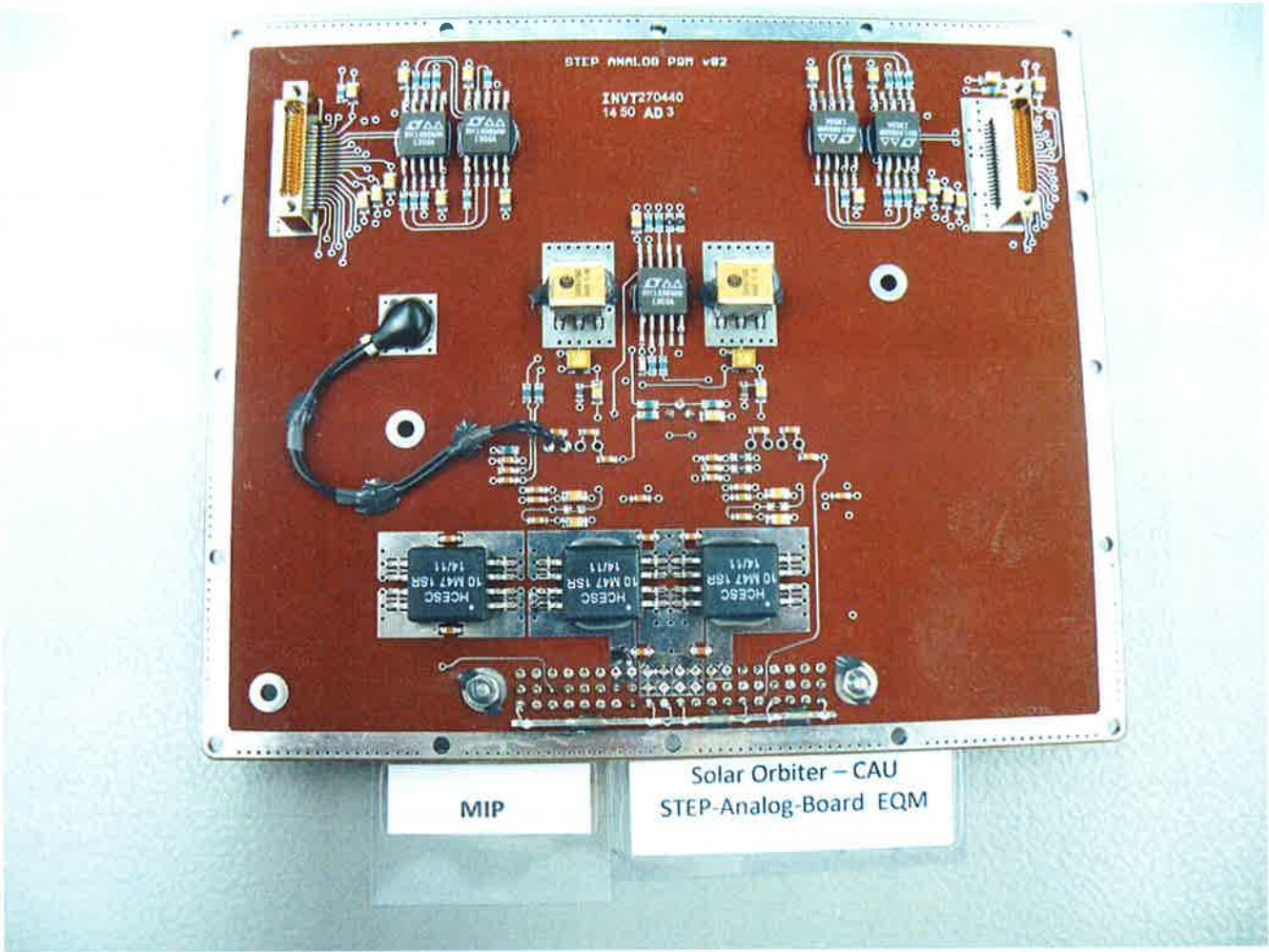
STEP-LVPS-Board Ansicht: BS



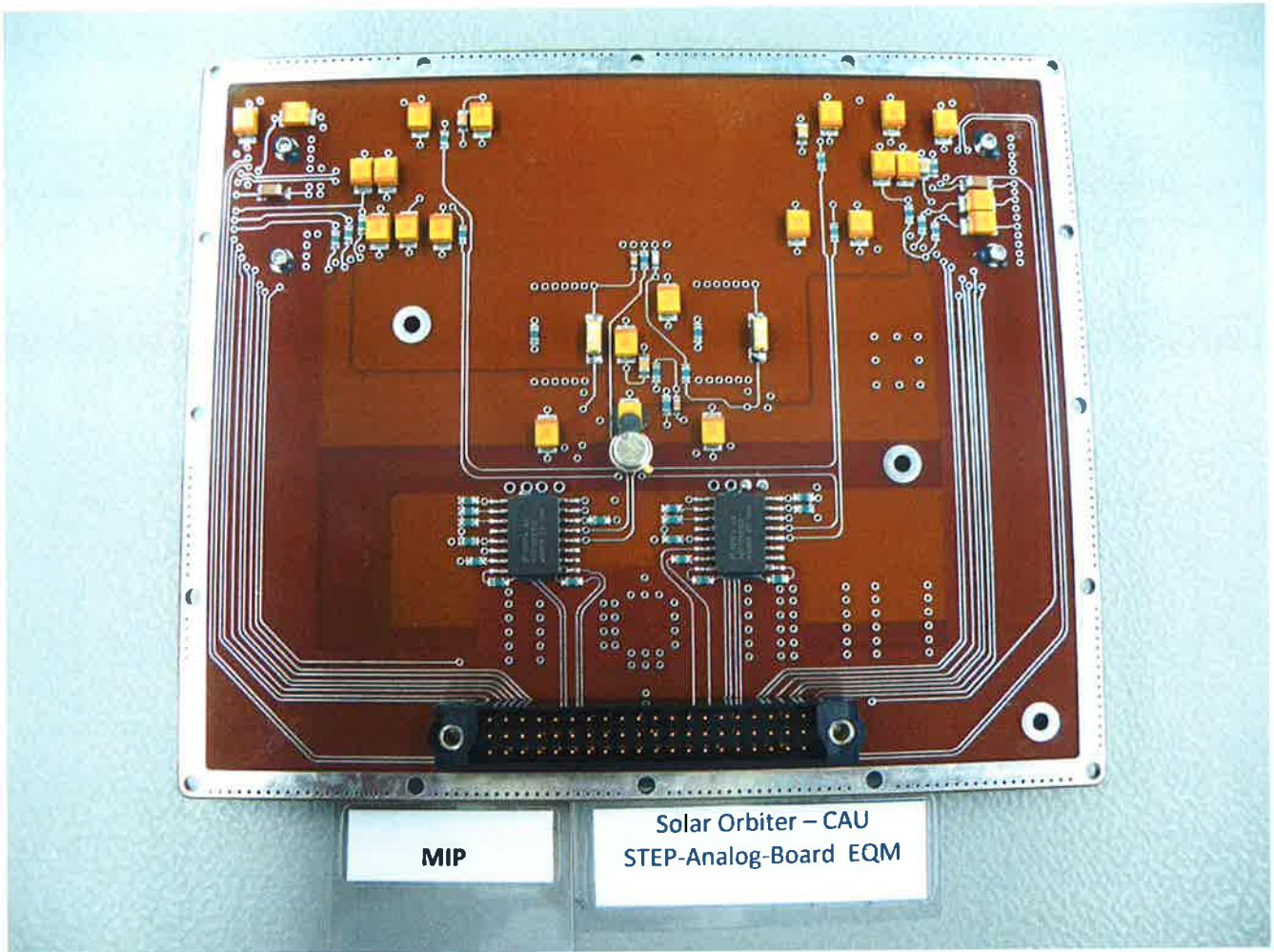
STEP-LVPS-Board Ansicht: LS



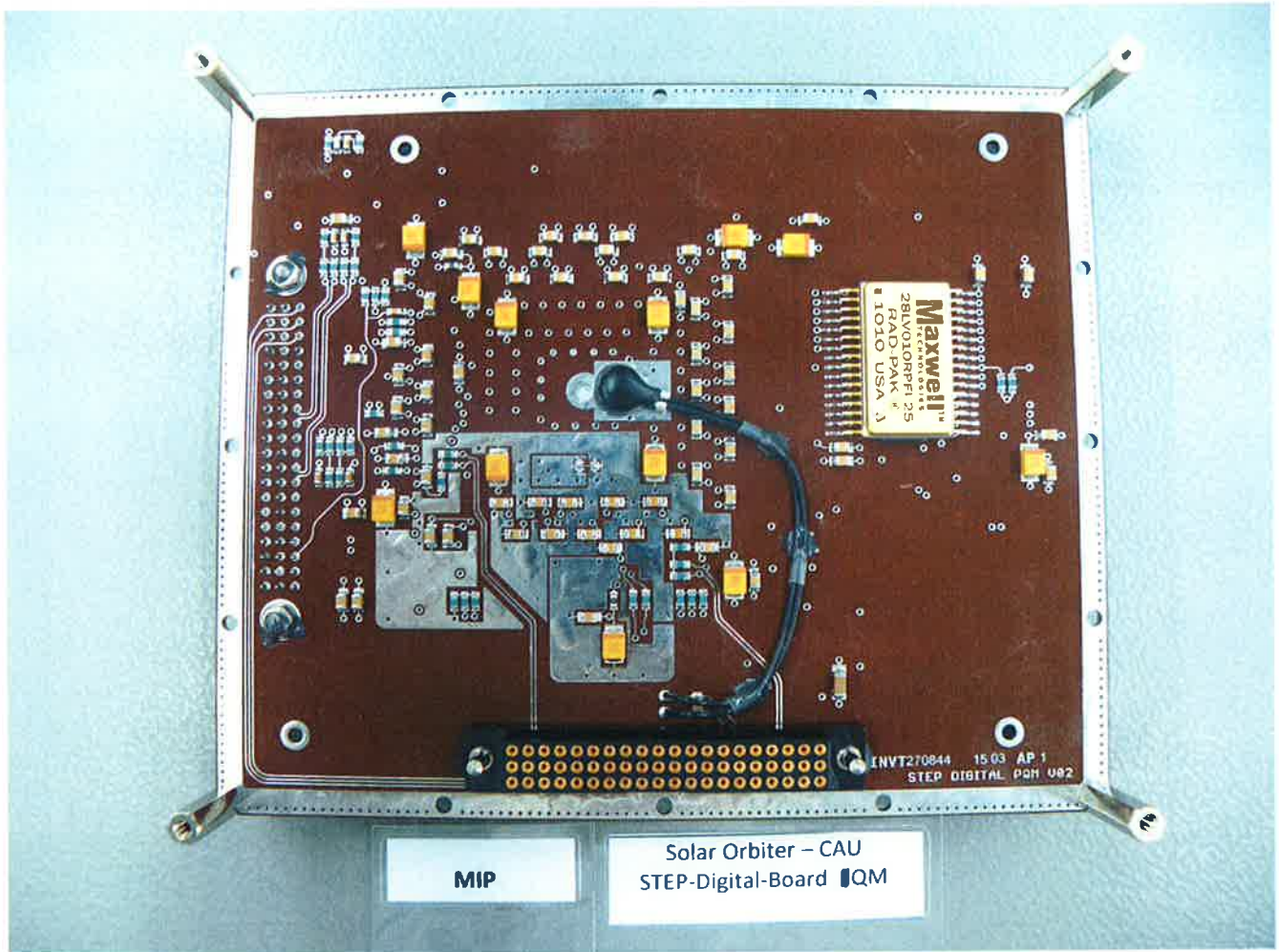
STEP-Analog-Board Ansicht: BS



STEP-Analog-Board Ansicht: LS



STEP-Digital-Board Ansicht: BS



STEP-Digital-Board Ansicht: LS

